

低シリコーン剥離フィルム

HP-S1

特長

低シリコーン剥離処理フィルムで、さまざまな基材に処理することが可能です。耐熱性に優れた特性があります。

構成



物性データ

項目	単位	代表値
剥離力【31B法】	mN/25mm	1000
接触角	degree	100

剥離力 測定方法

テープ : 日東No.31B
速度 : 0.3 m/min
角度 : 180°
条件 : 常温で20時間放置後の剥離力 (セバ剥離)

※ 上記の数値は代表値であり、保証値ではございません。

※ 上記の数値は、75μm品で測定しております。



株式会社フジコー



0877-28-6111



0877-28-6114

〒763-0092 香川県丸亀市川西町南甲 284番地 2



IP-RL-069

www.fujiko.jp